



特性

- 高热传导率
- 低挥发
- 低热阻抗
- 可用于点胶系统自动化操作
- 长期可靠性

应用

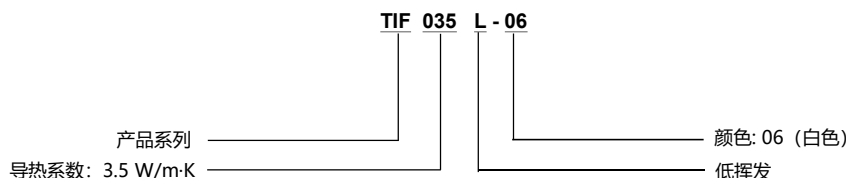
- 散热器底部或框架
- LED液晶显示屏背光管、LED灯具
- 高速硬盘驱动器
- 微型热管散热器
- 汽车发动机控制装置
- 通讯硬件
- 半导体自动试验设备

TIF®035L-06 是一款低挥发硅凝胶型的间隙填充材料，采用特殊配方与填料混合制成，兼具高导热性能与柔软特性。与一般导热硅油相比，本品具备更高的黏度，可有效防止填料与硅胶基材的分离，并抑制填料迁移，有助于稳定控制热传导效率。其施作方式与导热膏类似，适用于商用点胶或自动化设备操作。

TIF®035L-06 特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	白色	目视
结构&成份	陶瓷填充硅材料	-
挤出量 (g/min)	45	兆科测试 (30 cc针筒/ 管口直径 2.5 mm/ 90 psi)
密度 (g/cm ³)	3.2	ASTM D792
导热系数 (W/m·K)	3.5	ASTM D5470
热阻抗 (°C·in ² /W) @10psi	0.08	ASTM D5470
热阻抗 (°C·in ² /W) @50psi	0.07	ASTM D5470
建议使用温度范围 (°C)	-40~200	-
击穿强度 (V/mm)	≥5000	ASTM D149
体积电阻率 (Ohm·cm)	> 1.0×10 ¹²	ASTM D257
最小界面厚度 (mm)	0.15	-
阻燃等级	V-0	UL94
ΣD3-D12 (PPm)	< 100	EPA8270

产品型号说明



产品规格

30 cc/支, 50cc/支, 300 cc/支, 或用于自动化应用的定制包装。

如想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科技术有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIF035L-06-0826